

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 09-162444  
(43) Date of publication of application : 20.06.1997

(51)Int.Cl. H01L 33/00

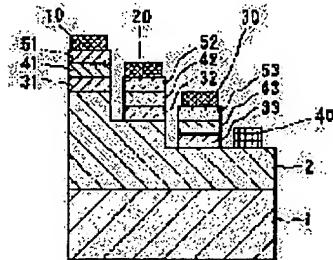
(21)Application number : 07-321755 (71)Applicant : NICHIA CHEM IND LTD  
(22)Date of filing : 11.12.1995 (72)Inventor : NAKAMURA SHUJI

**(54) NITRIDE SEMICONDUCTOR MULTI-COLOR LIGHT EMITTING DEVICE AND ITS PRODUCTION**

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To realize a highly fine display by providing a device capable of multi-color light emission by means of one chip and its production method by using a nitride semiconductor.

**SOLUTION:** After a nitride semiconductor layer having a first active layer 31 is formed on a substrate 1, another nitride semiconductor layer provided with a second active layer 32 whose band gap energy is different from that of the layer 31 is partly grown apart from the layer 31. Thus, since unit light emitting elements including active layers formed of nitride semiconductors of which band gap energies are different from each other are separately formed on the same substrate, multi-color light emission can be realized by only one chip.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 20.02.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 16.10.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-162444

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>  
H 01 L 33/00

識別記号 庁内整理番号

F I  
H 01 L 33/00

技術表示箇所  
F  
C

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平7-321755

(22)出願日

平成7年(1995)12月11日

(71)出願人 000226057

日亞化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 中村 修二

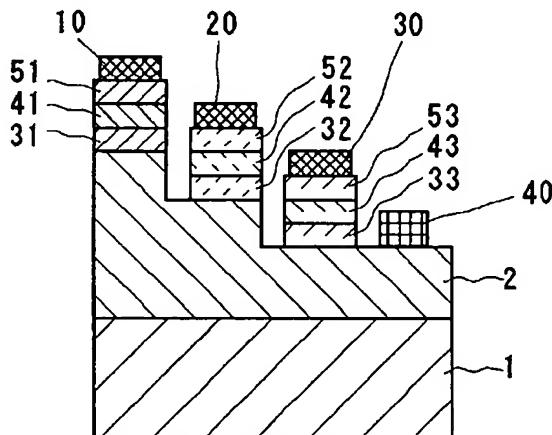
徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亞化  
学工業株式会社内

(54)【発明の名称】窒化物半導体多色発光素子及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】窒化物半導体を用いて、一チップで多色発光できる素子とその製造方法を提供することにより、高精度なディスプレイを実現する。

【構成】基板上に第一の活性層を有する窒化物半導体層を形成した後、第一の活性層とは別に、第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二の活性層を有する窒化物半導体層を部分的に成長させることにより、同一基板上に互いにバンドギャップエネルギーが異なる窒化物半導体よりなる活性層を有する単位発光素子が離して形成できるため、一チップで多色発光が可能となる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 同一基板上に互いにバンドギャップエネルギーが異なる窒化物半導体よりなる活性層を有する単位発光素子が、それぞれ隔離して形成されていることを特徴とする窒化物半導体多色発光素子。

【請求項2】 基板上に第一の活性層を有する窒化物半導体層を形成した後、第一の活性層とは別に、第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二の活性層を有する窒化物半導体層を部分的に成長させることを特徴とする窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

【請求項3】 基板上に第一の活性層を有する第一の窒化物半導体層を形成した後、その第一の窒化物半導体層の一部をエッチングにより除去し、エッチングにより露出された面に、第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二の活性層を有する第二の窒化物半導体層を成長させることを特徴とする窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

【請求項4】 前記第二の活性層のバンドギャップエネルギーが第一のバンドギャップエネルギーよりも小さいことを特徴とする請求項2または請求項3に記載の窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は窒化物半導体 ( $In_xA_{1-x-y}N$ 、  $0 \leq x, y \leq 1$ ) よりなる LED 等の発光素子とその製造方法に係り、特に異なるバンドギャップエネルギーを有する窒化物半導体が同一素子内に形成された多色発光素子とその製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 窒化物半導体はバンドギャップエネルギーが  $1.96\text{ eV} \sim 6.16\text{ eV}$  であり、この材料一つでフルカラーディスプレイが実現できる可能性があるため、従来より発光素子の材料として研究されている。そして最近、高輝度な青色 LED と純緑色に発光する緑色 LED が個々に実用化された。またこの材料を用いた同一発光素子内での多色発光素子の作製も試みられている。

【0003】 例えば特開平6-53549号公報、特開平6-29574号公報に窒化物半導体よりなる多色発光素子が示されている。これらの公報では、バンドギャップエネルギーの異なる  $i$  型の  $InGaN$  を活性層とし、この活性層を  $n$  型層の上に積層した多色発光素子が示されている。しかしこの技術は高抵抗な  $i$  型層を活性層とするため、発光効率が悪く実用性に乏しいと言う問題がある。

【0004】 また、特開平7-183576号公報では低抵抗な  $InGaN$  を活性層とした單一ダブルヘテロ構造を基板上に複数積層した多色発光素子が示されている。この技術は  $p-n$  接合を複数積層するため、同一素子

内において発光素子がサイリスタになる可能性がある。また、前記技術と同様に電極を取り出すために多くのエッチング工程が必要となり製造工程上好ましくない。また活性層と基板との間に、バンドギャップエネルギーの異なる他の活性層が存在するので、単一色を発光させる場合に他の活性層が発光してしまう可能性がある。

【0005】 LED はチップの大きさが通常  $300\text{ }\mu\text{m}$  角以上あるので、精細な画像を得ることは不可能である。そのため LED ディスプレイはスタジアム、劇場のような大画面を必要とする場所にしか使用できなかつた。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】 一個のチップで一画素が構成できれば精細な画像を実現することができる。また、細かい画素を多数含む一枚のウェーハで一画面を構成することも可能となる。従って本発明の目的とするところは、窒化物半導体を用いて多色発光できる素子とその製造方法を提供することにより、高精細なディスプレイを実現することにある。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】 本発明の多色発光素子は、同一基板上に互いにバンドギャップエネルギーが異なる窒化物半導体よりなる活性層を有する単位発光素子が、それぞれ隔離して形成されていることを特徴とする。

【0008】 また本発明の多色発光素子の製造方法は、基板上に第一の活性層を有する窒化物半導体層を形成した後、第一の活性層とは別に、第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二の活性層を有する窒化物半導体層を部分的に成長させることを特徴とする。

【0009】 さらにまた、本発明の製造方法は基板上に第一の活性層を有する第一の窒化物半導体層を形成した後、その第一の窒化物半導体層の一部をエッチングにより除去し、エッチングにより露出された面に、第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二の活性層を有する第二の窒化物半導体層を成長させることを特徴とする。

【0010】 また本発明の製造方法において、第二の活性層のバンドギャップエネルギーが第一のバンドギャップエネルギーよりも小さいことを特徴とする。つまり波長の短い発光波長を有する活性層を先に成長させ、次に波長の長い活性層を成長させることを特徴とする。

【0011】 図1は本発明の一実施例に係る多色発光素子の構造を示す模式的な断面図である。この発光素子は互いに分離独立して形成された3つのダブルヘテロ構造を有し、共通の基板1の上に、共通の  $n$  型コンタクト層2を有する。第一の構造は  $n$  型コンタクト層の上2に、第一の活性層31、第一の  $p$  型クラッド層41、第一の  $p$  型コンタクト層51を有する。第二の構造は第一の構造と独立して、第二の活性層32、第二の  $p$  型クラッド

層42、第三のp型コンタクト層52を有する。さらに第三の構造は、第一の構造及び第二の構造と独立して、第三の活性層33と第三のp型クラッド層43、第三のp型コンタクト層53とを有する。さらにn型コンタクト層2の表面には共通の負電極40が設けられ、p型コンタクト層51、52、53の表面にはそれぞれ正電極10、20、30とが設けられている。

【0012】基板1にはサファイア(A<sub>1</sub><sub>2</sub>O<sub>3</sub>、C面、A面、R面を含む)、スピネル(MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、111面を含む)、SiC、Si、GaN等窒化物半導体を成長させるために提案されている基板を使用できる。

【0013】n型コンタクト層2はn型のIn<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>Ga<sub>1-x-y</sub>N(0≤x, 0≤y, x+y≤1)で構成することができ、特にGaNとするとキャリア濃度が高い層が得られ、負電極材料と好ましいオーミック接触が得られる。なおn型ドーパントとしては、例えばSi、Ge、Sn、Se等を使用でき、これらのn型ドーパントを半導体成長時にドープすることにより好ましいn型とできる。なおこのコンタクト層2はクラッド層としても作用している。

【0014】第一の活性層31、第二の活性層32、第三の活性層33はいずれもコンタクト層2、p型クラッド層41、42、43よりもバンドギャップエネルギーの小さいIn<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>Ga<sub>1-x-y</sub>N(0≤x, 0≤y, x+y≤1)で構成することができ、好ましくはIn<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>Nとすると、紫～赤色まで発光させることができる。さらにこの活性層に前記したn型ドーパント、および/またはMg、Zn、Cd、Be、Ca等のp型ドーパントをドープして発光波長を調整しても良い。特に好ましくはこの活性層を単一量子井戸(SQW:Single-Quantum-Well)構造、若しくは多重量子井戸(MQW:Multi-Quantum-Well)構造を有するIn<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(0≤x<1)とすると高出力な素子が得られる。SQW、MQWとはノンドープのInGaNによる量子準位間の発光が得られる活性層の構造を指し、例えばSQWでは活性層を単一組成のIn<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(0≤x<1)で構成した層であり、In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>Nの膜厚を10nm以下、さらに好ましくは7nm以下とすることにより量子準位間の強い発光が得られる。またMQWは組成比の異なるIn<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(この場合x=0、x=1を含む)の薄膜を複数積層した多層膜とする。このように活性層をSQW、MQWとすることにより量子準位間発光で、約365nm～660nmまでの発光が得られる。量子構造の井戸層の厚さとしては、前記のように7nm以下が好ましい。多重量子井戸構造では井戸層はIn<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>Nで構成し、障壁層は同じくIn<sub>y</sub>Ga<sub>1-y</sub>N(Y<x、この場合y=0を含む)で構成することが望ましい。障壁層の膜厚は15nm以下、さらに好ましくは12nm以下にすると高出力な発光素子が得られる。また、活性層31、32、33とn型コンタクト層2との間に、活性層よりもバン

ドギャップの大きいn型の窒化物半導体よりなるクラッド層を一層、または複数層形成しても良い。

【0015】次に、第一のp型クラッド層41、第二のp型クラッド層42、第三のp型クラッド層43はp型ドーパントがドープされて活性層よりもバンドギャップエネルギーの大きいp型In<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>Ga<sub>1-x-y</sub>N(0≤x, 0≤y, x+y≤1)で構成することができ、特に好ましくはAl<sub>y</sub>Ga<sub>1-y</sub>Nのように少なくともAlを含む窒化物半導体が活性層と接するようにすると高出力な素子が得られる。

【0016】次に第一のp型コンタクト層51、第二のp型コンタクト層52、第三のp型コンタクト層3も同じくp型ドーパントがドープされたp型In<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>Ga<sub>1-x-y</sub>N(0≤x, 0≤y, x+y≤1)で構成することができ、特にp型GaNとすると高キャリア濃度のp型層が得られるので正電極の材料と好ましいオーミック接触が得られる。また本発明の発光素子において、p型コンタクト層とp型クラッド層との間、またはp型クラッド層と活性層との間に他のp型窒化物半導体よりなるクラッド層を形成しても良い。

【0017】

【作用】図1に示すように、本発明の発光素子は、異なるバンドギャップエネルギーを有する活性層41、42、43を含む単位発光素子がそれぞれ隔離して形成されている。このため、活性層41とn型コンタクト層2との間には、他のバンドギャップエネルギーを有する活性層が存在しない。しかも第一のp型コンタクト層51とn型コンタクト層2との間にはp-n接合が一ヶ所しかないとため、電流を流しても発光素子として作用するのみであってサイリスタにならない。従って、全ての電極に電流を流した状態において、それぞれの活性層が独自のバンドギャップエネルギーに相当する発光を示すため、單一色でも混色することなく発光可能である。

【0018】さらに本発明の製造方法では、バンドギャップエネルギーの大きい活性層を先に成長させ、次にエネルギーの小さい活性層を成長させる。この理由はエネルギーの大きい活性層の方が分解しにくいことによる。例えば第一の活性層をIn組成の小さいInGaN、第二の活性層をIn組成の大きいInGaNとすると、第二の活性層成長中に、先に成長させた第一の活性層が分解しにくい。このため、波長の揃った多色発光素子を実現できる。

【0019】

【実施例】以下、図面を参照して本発明の製造方法について詳説する。以下の実施例は有機金属気相成長法による窒化物半導体の成長方法を述べており、図2乃至図8は本発明の実施例の一工程において得られる発光素子の構造を示す模式的な断面図である。

【0020】【実施例1】サファイア基板1の上に、原50料ガスにTMG(トリメチルガリウム)、アンモニアを

用いて、500°CでGaNよりなるバッファ層を200オングストロームの膜厚で成長させた。なおこのバッファ層は特に図示していない。バッファ層は他にAlN、GaN等が成長されるが基板の種類によっては成長されない場合もある。

【0021】次に温度を1050°Cにして、原料ガスにTMG、アンモニア、不純物ガスとしてシランガスを用い、Siドープn型GaNよりなるn型コンタクト層2を10μmの膜厚で成長させた。

【0022】次に温度を800°Cにして、TMG、TMI(トリメチルインジウム)、アンモニアを用い、ノンドープのIn0.25GaN0.75Nよりなる第一の活性層31を20オングストロームの膜厚で成長させた。この第一の活性層31は膜厚が非常に薄いため量子効果により单一量子井戸構造となっている。この活性層は本来の組成であれば435nmに主発光波長を有しているが、量子効果と結晶の歪みにより、およそ450nmに発光する。

【0023】次に再び温度を1050°Cにして、TMG、TMA(トリメチルアルミニウム)、アンモニア、不純物ガスとしてCp2Mg(シクロペンタジエニルマグネシウム)を用い、Mgドープp型Al0.2Ga0.8Nよりなる第一のp型クラッド層41を0.2μmの膜厚で成長させた。

【0024】続いて、TMG、アンモニア、Cp2Mgを用い、Mgドープp型GaNよりなる第一のp型コンタクト層51を0.5μmの膜厚で成長させた。以上まで窒化物半導体を積層したウェーハの断面図が図2である。

【0025】ウェーハを反応装置から取り出し、最上層の第一のp型コンタクト層51の一部にフォトリソグラフィー技術を用いて保護膜を形成し、第一のp型コンタクト層51、第一のp型クラッド層41、第一の活性層31、およびn型コンタクト層2の一部をエッティングにより除去し、n型コンタクト層2の第一のエッティング面を露出させた。

【0026】次に、図3に示すように活性層を含む発光素子の表面にSiO<sub>2</sub>よりなる第一のマスク70を形成した。第一のマスク70形成後のウェーハの部分的な構造を示す図が図3である。このマスクの表面には窒化物半導体は成長しない。

【0027】第一のマスクが形成されたウェーハを再び反応容器に設置し、第一のエッティング面の表面に、In0.45GaN0.55Nよりなる第二の活性層32を20オングストロームと、Mgドープp型Al0.2Ga0.8Nよりなる第二のp型クラッド層42を0.2μmと、Mgドープp型GaNよりなる第二のp型コンタクト層52を0.5μmの膜厚で成長させた。この第二の活性層32はおよそ520nm付近の緑色発光を示す。成長後のウェーハの部分的な構造を示す図が図4である。

【0028】成長後、ウェーハを反応容器から取り出し、第一のマスク70をフッ酸で除去した後、先ほどと同様にして、第一の活性層31と第二のp型コンタクト層52の表面の一部に保護膜を形成した。さらに同様にして保護膜の上からエッティングを行いn型コンタクト層2の第二のエッティング面を露出させた。

【0029】次に、図5に示すように、第一の活性層31を含む発光素子の表面と、第二の活性層32を含む発光素子の表面とにまたがって、SiO<sub>2</sub>よりなる第二のマスク80を形成した。

【0030】さらに、図5に示すウェーハを再度反応容器に設置し、第二のエッティング面の表面に、In0.8GaN0.2Nよりなる第三の活性層33を20オングストロームと、Mgドープp型Al0.2Ga0.8Nよりなる第三のp型クラッド層43を0.2μmと、Mgドープp型GaNよりなる第三のp型コンタクト層53を0.5μmの膜厚で成長させた。この第三の活性層32はおよそ620nm付近の赤色発光を示す。成長後のウェーハの部分的な構造を示す図が図6である。

20 【0031】成長後、ウェーハを反応容器から取り出し、第二のマスク80を除去した後、同様にして、第三のp型コンタクト層53の表面の一部に保護膜を形成してエッティングを行い、負電極40を形成すべきn型コンタクト層2の表面を露出させた。その後、保護膜を除去して、常法に従い第一のp型コンタクト層51と、第二のp型コンタクト層52と、第三のp型コンタクト層53の表面に、それぞれ正電極10、20、30を形成した。また露出させたn型コンタクト層2の表面にも同様にして負電極40を形成した。電極形成後、それぞれ30 活性層を有する発光素子が単位基板の上に一個づつ載るようにして、ウェーハをチップ状に切断して本発明の多色発光素子を得た。

【0032】この多色発光素子の負電極40を共通として、正電極10、20、30に所定の電流を流したところ、単一発光色は色純度良く再現でき、しかも混色も非常に良好な白色発光を示した。なお図9は本発明の一実施例に係る多色発光素子を電極側から見た具体的な平面図であり、図10は図9の発光素子の形状を示す斜視図である。なお図9及び図10は、図1乃至図8に示す

40 断面図とは必ずしも対応しておらず、強いて対応させるならば図9に示す「コ」の字状の一点鎖線で切断して、一点鎖線を伸ばした状態が模式的な断面図に相当する。

【0033】【実施例2】図11は本発明の他の実施例による多色発光素子の構造を示す模式的な断面図である。この多色発光素子が実施例1の発光素子と異なる点は、エッティングを行わず選択成長によって、異なるバンドギャップエネルギーを有する活性層を含む発光素子を成長させている。つまり基板上に第一の活性層を有する窒化物半導体層を形成した後、第一の活性層とは別に、50 第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二

の活性層を有する窒化物半導体層を部分的に成長させている。

【0034】まず、図12に示すようにサファイア基板の上にGaNよりなるバッファ層を介して、Siドープn型GaNよりなるn型コンタクト層2を成長させ、その上にIn0.2Ga0.8Nよりなる第一の活性層31を成長させた後、ウェーハを反応容器から取り出す。

【0035】第一の活性層31の上に、SiO<sub>2</sub>よりなる第四のマスク90を部分的に形成する。つまり、第一の活性層31を成長させる部分を除いてマスクを形成する。そしてマスクが形成されたウェーハを再度反応容器に戻し、n型コンタクト層2の上に第一の活性層31、第一のp型クラッド層41、第一のp型コンタクト層51を成長させる。成長後のウェーハの部分的な断面図が図12である。

【0036】成長後マスクを除去して、再び第一の活性層31、第一のp型クラッド層41、第一のp型コンタクト層51を含む発光素子全面と、n型コンタクト層2の表面の一部に第五のマスクを形成して、同様にして第二の活性層32、第二のp型クラッド層42、第二のp型コンタクト層52を成長させる。この工程以後の断面図は図12と類似しているので特に図示しない。

【0037】第二のp型コンタクト層を成長させた後、マスクを除去して同様にして、第三の活性層33、第二のp型クラッド層43、第三のp型コンタクト層53を成長させる。後は常法に従い、各コンタクト層に電極を設けることにより図11に示す構造の多色発光素子を得ることができる。

【0038】なお、実施例1、2はn型コンタクト層の上に数々の保護膜を形成して後、バンドギャップの異なる活性層を成長させる方法について述べたが、本発明の方法では、n型コンタクト層2と、第一の活性層31、第二の活性層32、及び第三の活性層33とをアイランド状に成長させ、それらの活性層の表面を除く部分に新たな保護膜を形成した後、p型クラッド層、p型コンタクト層を一度に形成しても良い。

#### 【0039】

【発明の効果】以上説明したように本発明の多色発光素子は同一基板上に互いにバンドギャップエネルギーが異なる窒化物半導体よりなる活性層を有する単位発光素子が、隔離して形成されていることにより、単一発光色が混色せずに発光できる。しかも活性層を従来のように高

抵抗なi型とせず、低抵抗なInGaNとして、ダブルヘテロ構造とすると低電圧で駆動でき、素子の効率が非常に優れている。このようにしてチップに複数の窒化物半導体の発光素子を作製することにより、一画素が小さくできるため高精細度なディスプレイを実現する上で、本発明は非常に有利である。また一枚のウェーハ上に多数の電極を有する素子ができるため、チップ状にウェーハを分離せず、そのままウェーハの電極を接続してディスプレイとすることもできる。

#### 10 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係る多色発光素子の構造を示す模式断面図。

【図2】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

【図3】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

【図4】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

【図5】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

#### 20 【図6】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

【図7】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

【図8】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

【図9】 本発明一実施例に係る素子を電極側から見た平面図。

【図10】 図9の素子の形状を示す斜視図

#### 30 【図11】 本発明の他の実施例に係る素子の構造を示す模式断面図。

【図12】 本発明の方法の一工程において得られる素子の構造を示す模式断面図。

#### 【符号の説明】

1・・・基板

2・・・n型コンタクト層

31、32、33・・・活性層

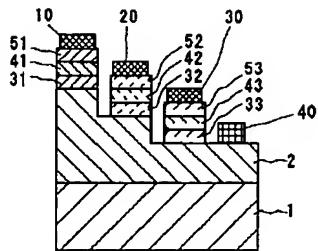
41、42、43・・・p型クラッド層

51、52、53・・・p型コンタクト層

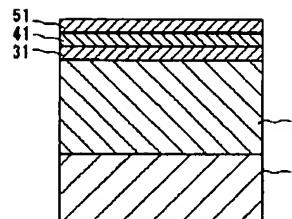
#### 40 10、20、30・・・正電極

40・・・負電極

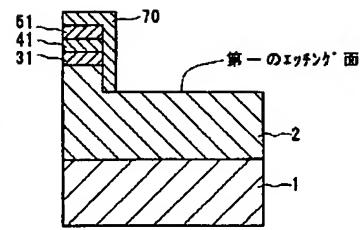
【図1】



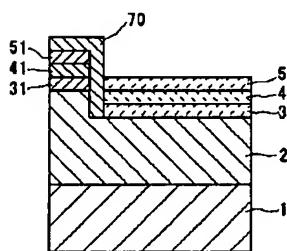
【図2】



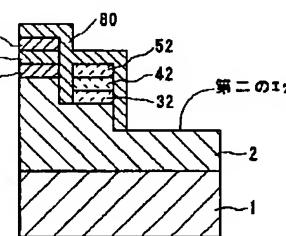
【図3】



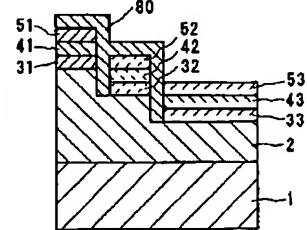
【図4】



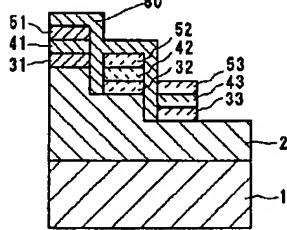
【図5】



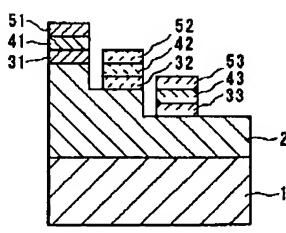
【図6】



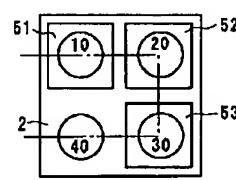
【図7】



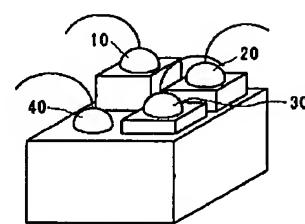
【図8】



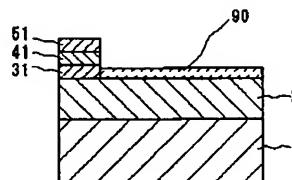
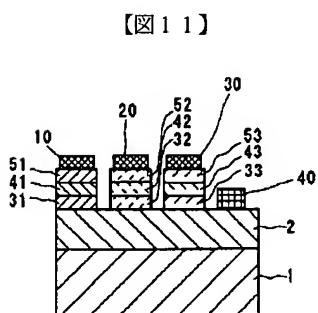
【図9】



【図10】



【図12】



【図11】

## 【手続補正書】

【提出日】平成7年12月19日

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

## 【補正内容】

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 同一基板上に互いにバンドギャップエネルギーが異なる窒化物半導体による活性層を有する単位発光素子が、それぞれ隔離して形成されていることを特徴とする窒化物半導体多色発光素子。

【請求項2】 基板上に第一の活性層を有する第一の窒化物半導体層を形成した後、第一の活性層とは別に、第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二の活性層を有する第二の窒化物半導体層を部分的に成長させることを特徴とする窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

【請求項3】 前記第一および第二の活性層とは別に、バンドギャップエネルギーが異なる第三の活性層を有する第三の窒化物半導体層を部分的に成長させることを特徴とする請求項2に記載の窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

【請求項4】 基板上に第一の活性層を有する第一の窒

化物半導体層を形成した後、その第一の窒化物半導体層の一部をエッティングにより除去し、エッティングにより露出された面に、第一の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第二の活性層を有する第二の窒化物半導体層を成長させることを特徴とする窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

【請求項5】 前記第二の窒化物半導体層の一部をエッティングにより除去し、エッティングにより露出された面

10 に、前記第一及び第二の活性層とバンドギャップエネルギーが異なる第三の活性層を有する第三の窒化物半導体層を成長させることを特徴とする請求項4に記載の窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

【請求項6】 前記第二の活性層のバンドギャップエネルギーが、第一の活性層のバンドギャップエネルギーよりも小さいことを特徴とする請求項2乃至請求項5の内のいづれか一項に記載の窒化物半導体多色発光素子の製造方法。

【請求項7】 前記第三の活性層のバンドギャップエネルギーが、第一および第二のバンドギャップエネルギーよりも小さいことを特徴とする請求項3若しくは請求項5又は請求項6の内のいづれか一項に記載の窒化物半導体多色発光素子の製造方法。